

招商证券股份有限公司

关于

成都锐成芯微科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）



深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(下称“《首发办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(下称“《保荐管理办法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

(本发行保荐书如无特别说明,相关用语含义与《成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》相同)

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
第一节 本次证券发行基本情况	3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍.....	3
二、发行人基本情况.....	3
三、保荐机构与发行人之间的关联关系.....	4
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见.....	5
第二节 保荐机构的承诺	8
第三节 对本次证券发行的推荐意见	9
一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序.....	9
二、发行人符合《证券法》规定的发行条件.....	9
三、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的发行条件.....	11
四、发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》有关规定.....	12
五、发行人符合科创板定位的说明.....	15
六、发行人存在的主要问题和风险.....	19
七、发行人的发展前景评价.....	23
八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见.....	28
九、对本次证券发行的推荐意见.....	30
附件：	32

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构	保荐代表人	项目协办人	其他项目组成员
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）	姜博、王越	汪军鹏	吴宏兴、张远明、黄荣、王昭阳、张楚仪、杜星昱、李泓润、王雅、刘旭东、赵洪磊

（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况

1、姜博主要保荐业务执业情况如下：

项目名称	保荐工作	项目类型	项目阶段
芯原股份（688521.SH）IPO项目	担任项目协办人	科创板 IPO	已于 2020 年 8 月 18 日完成上市
科达制造（600499.SH）非公开发行股票项目	担任项目协办人	主板非公开发行	已于 2020 年 6 月 6 日完成上市
概伦电子（688206.SH）IPO项目	担任保荐代表人	科创板 IPO	已于 2021 年 12 月 28 日完成上市
成都锐成芯微科技股份有限公司 IPO 项目	担任保荐代表人	科创板 IPO	拟申报

2、王越主要保荐业务执业情况如下：

项目名称	保荐工作	项目类型	项目阶段
安阳钢铁（600659.SH）非公开发行项目	担任项目组成员	主板非公开发行	已于 2019 年 5 月 30 日完成上市
成都锐成芯微科技股份有限公司 IPO 项目	担任保荐代表人	科创板 IPO	拟申报

（二）项目协办人主要保荐业务执业情况

汪军鹏主要保荐业务执业情况如下：

项目名称	工作职责	项目类型	项目阶段
概伦电子（688206.SH）IPO项目	担任项目组成员	科创板 IPO	已于 2021 年 12 月 28 日完成上市
成都锐成芯微科技股份有限公司 IPO 项目	担任项目协办人	科创板 IPO	拟申报

二、发行人基本情况

发行人名称	成都锐成芯微科技股份有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 3 号楼 A 区 9 层 901、902、903、904、905 室

有限公司成立日期	2011年12月8日
股份公司成立日期	2016年7月22日
联系方式	028-61682666
经营范围	研发、销售电子元器件、计算机软硬件、电子设备；集成电路开发并提供技术咨询；计算机系统集成；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型	人民币普通股（A股）

三、保荐机构与发行人之间的关联关系

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本发行保荐书出具日，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况如下：

1、招商基金管理有限公司为本次发行上市的保荐人及主承销商招商证券股份有限公司持股45%的参股公司，招商财富资产管理有限公司是招商基金管理有限公司的全资子公司。

招商证券通过招商财富资产管理有限公司持股达晨创鸿，从而间接持有发行人0.0910%的股份；招商证券通过招商财富资产管理有限公司持股艾派克，从而间接持有发行人0.0004%的股份；招商证券通过招商财富资产管理有限公司持股泰达新原、苏民投、华虹虹芯，从而间接持有发行人少量股份，持股比例均不超过0.0001%。

2、招商证券资产管理有限公司、招商证券投资有限公司、招商致远资本投资有限公司为保荐人（主承销商）全资子公司。

招商证券资产管理有限公司、招商证券投资有限公司、招商致远资本投资有限公司均持有发行人股东泰达新原、苏民投、华虹虹芯的权益，招商证券从而间接持有发行人少量股份，间接持股比例均不超过0.0001%。

上述公司具有独立的业务经营体系；在劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；并建立了健全的内部经营管理机构，设置了相应的职能管理部门，独立行使经营管理职权。因此与发行人之间的关联关系不会影响本保荐机构和保荐代表人公正地履行保荐职责。

除前述外，根据国家企业信用信息公示系统公开信息显示，公司与本次发行有关的中介机构负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本发行保荐书出具日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有本保荐机构或本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方的任何股份的情形。

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形。

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系

除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）本保荐机构的内部审核程序

第一阶段：项目的立项审查阶段

投资银行业务立项委员会为立项决策机构，对于投资银行类项目是否予以立项进行决策，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的。

IPO 保荐主承销项目设置两个立项时点。在正式协议签署之前，项目组提起项目立项申请；在辅导协议签署之前，项目组提起申报立项申请。项目组需对拟申请立项的项目进行尽职调查，认为项目可行后方可向投资银行委员会质量控制

部（以下简称“质量控制部”）提出立项申请。质量控制部实施保荐项目的立项审查，对所有保荐项目进行立项前评估。

质量控制部负责组织召开立项会，每次立项会由5名立项委员参会，4票（含）及以上为“同意”的，且主任委员未行使一票暂缓及否决权的，视为立项通过，2票（含）及以上为“反对”的，或主任委员行使一票否决权的，视为立项被否决，其余情况视为“暂缓”。

第二阶段：项目的管理和质量控制阶段

保荐项目执行过程中，质量控制部适时参与项目的进展过程，以便对项目进行事中的管理和控制，进一步保证和提高项目质量。

质量控制部旨在从项目执行的前中期介入，一方面前置风险控制措施，另一方面给予项目技术指导。同时，质量控制部审核人员负责项目尽职调查工作审查、项目实施的过程控制，视情况参与项目整体方案的制订。

质量控制部负责组织对IPO项目进行核查，核查内容包括对项目尽职调查工作底稿进行审阅，对相关专业意见和推荐文件是否依据充分，项目组是否勤勉尽责进行判断，并最终出具核查报告。公司风险管理中心内核部（以下简称“内核部”）、风险管理中心风险管理部（以下简称“风险管理部”）及法律合规部认为有需要的，可以一同参与核查工作。

项目组进行回复后，质量控制部负责组织召开项目初审会就项目存在的问题与项目组进行讨论，公司内核部、风险管理部、法律合规部等公司内控部门可以参会讨论。

质量控制部根据初审会讨论结果、项目组尽职调查工作完成情况、工作底稿的完备程度出具质量控制报告以及底稿验收意见，验收通过的方能启动内核会审议程序。

第三阶段：项目的内核审查阶段

本保荐机构实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发行承销业务的内核审查要求而制定的，是对所有保荐项目进行正式申报前的审核。

本保荐机构内核部根据《招商证券投资银行类业务内核委员会工作管理办法》及其附件《股权类业务内核小组议事规则》负责组织股权类业务内核小组成员召开内核会议，拟申报项目须经股权类业务内核小组的全体有效表决票的 2/3 以上同意且主任委员/副主任委员未行使一票否决权或一票暂缓权的情况下视为内核通过，并形成最终的内核意见。

（二）本保荐机构对锐成芯微本次证券发行上市的内核意见

本保荐机构股权类投资银行业务内核小组已核查了成都锐成芯微科技股份有限公司本次发行申请材料，并于 2022 年 5 月 23 日召开了内核会议。本次应参加内核会议的委员人数为 9 人，实际参加人数为 9 人，达到规定人数。经全体参会委员投票表决，9 票同意、0 票反对、0 票暂缓，表决通过。本保荐机构同意推荐成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料上报上海证券交易所、中国证券监督管理委员会。

第二节 保荐机构的承诺

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书；

（二）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定；

（三）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（四）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（五）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（六）保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（七）发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（八）对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（九）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序

（一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准

2022年4月26日，发行人依法召开第二届董事会2022年第3次会议，审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）发行人股东大会对本次证券发行上市的批准、授权

2022年5月16日，发行人依法召开股东大会，审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件

（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构

根据发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等内部控制制度及本保荐机构的核查，发行人已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。发行人目前有11名董事，其中4名为公司选任的独立董事；董事会下设4个专门委员会即：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会；发行人设3名监事，其中1名是由股东代表选任的监事，1名是由职工代表选任的监事。

根据本保荐机构的核查以及发行人的说明、发行人审计机构出具的《内部控制鉴证报告》、发行人律师出具的《法律意见书》，报告期内，发行人股东大会、董事会及监事会均独立运行，股东大会、董事会、监事会决议均能够得到有效执行，重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

综上所述，发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（二）发行人具有持续经营能力

根据发行人的说明、发行人审计机构出具的《审计报告》、发行人正在履行的重大经营合同及本保荐机构的核查，近三年发行人净资产持续快速增长，由2019年12月31日的5,034.11万元增长到2021年12月31日的59,203.44万元；发行人经营能力具有可持续性，近三年发行人营业收入复合增长率为87.02%，公司于2020年开始实现盈利，最近一年净利润增长率为1,141.95%；发行人具有良好的偿债能力，截至2021年12月31日，发行人资产负债率（合并口径）为31.64%，流动比率为3.03，速动比率为2.95。发行人财务状况良好，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

根据发行人的说明、发行人审计机构出具的《审计报告》、《内部控制鉴证报告》及本保荐机构的核查，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

根据相关政府主管部门出具的证明文件，发行人控股股东、实际控制人提供的无犯罪记录证明，以及发行人及其控股股东、实际控制人出具的声明与承诺，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

（五）发行人符合中国证监会规定的其他条件

发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，具体情况请参见“（四）发行人符合《注册办法》有关规定”相关内容。

综上，本保荐机构认为，发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件。

三、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的发行条件

本保荐机构依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）对发行人是否符合首次公开发行股票并在科创板上市的条件进行了逐项检查，核查情况如下：

（一）发行人申请在上海证券交易所科创板上市，应当符合下列条件：

- 1、符合中国证监会规定的发行条件；
- 2、发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元；
- 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上；
- 4、市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的标准；
- 5、上海证券交易所规定的其他上市条件。

保荐机构对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件以及符合《首发办法》规定的发行条件的核查情况，详见本发行保荐书之“二、发行人符合《证券法》规定的发行条件”及“四、发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》有关规定”。

截至本发行保荐书出具日，发行人注册资本为 5,543.2881 万元，发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元；本次拟公开发行不低于 18,477,627 股，本次公开发行及公开发售的股份占发行后总股本的比例不低于 25%。

（二）发行人申请在上海证券交易所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：

- 1、预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元；
- 2、预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，

且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%；

3、预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元；

4、预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元；

5、预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

公司拟适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条第（一）项上市标准中“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

公司 2021 年度营业收入为 36,710.41 万元，归属于公司普通股股东的净利润为 4,658.51 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 2,825.19 万元；参考报告期内发行人最近一次融资的公司投后估值 48.78 亿元，公司预计市值不低于 10 亿元。因此，公司满足上述规定的市值及财务指标。

综上，保荐机构认为发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

四、发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》有关规定

（一）符合《首发办法》第十条相关发行条件

本保荐机构核查了发行人的工商登记资料、营业执照、发行人现行有效的《公司章程》、发起人协议、发行人历次股东大会、相关审计报告、验资报告、评估报告、发行人律师出具的《法律意见书》等文件和本保荐机构的核查，发行人系以成立于 2011 年 12 月 8 日的成都锐成芯微科技有限公司于 2016 年 7 月 22 日整体变更设立为股份公司，因此，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；

根据发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等治理制度、内部控制制度、历次“三会”会议通知、会议决议、会议纪要等文件及本保荐机构的核查，发行人已依照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，建立和完善了符合上市要求的公司治理结构，在董事会下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，并根据自身及行业特点制定和优化了各项规章制度，发行人组织机构设置及运行情况良好。

根据本保荐机构的核查以及发行人的说明、发行人审计机构出具的《内部控制鉴证报告》、发行人律师出具的《法律意见书》，报告期内，发行人股东大会、董事会及监事会均独立运行，股东大会、董事会、监事会决议均能够得到有效执行，重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

经核查，本保荐机构认为，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，发行人符合《注册办法》第十条的规定。

（二）符合《首发办法》第十一条相关发行条件

根据查阅和分析发行人审计机构出具的《审计报告》、《内部控制鉴证报告》、发行人的重要会计科目明细帐、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的纳税资料、关联交易的会议记录、同行业公司经营情况、内部控制制度及其执行情况、发行人的书面说明或承诺等文件和本保荐机构的核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发办法》第十一条的规定。

（三）符合《首发办法》第十二条相关发行条件

1、经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，实地核查有关情况，并结合实际控制人调查表及对发行人董事、监事和高级管理人员的访

谈等资料。保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户等资料，发行人最近2年内主营业务未发生重大不利变化；经过对发行人历次股东大会、董事会决议资料、工商登记资料等文件的核查，本保荐机构认为发行人最近2年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

3、经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈、发行人审计机构出具的《审计报告》和发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

综上，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力。发行人符合《首发办法》第十二条的规定。

（四）符合《首发办法》第十三条相关发行条件

本保荐机构核查了发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策、发行人及其子公司所在地工商、税务、社保等行政管理部门对发行人遵守法律法规情况出具的相关证明，进行公开信息查询，并与发行人主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行访谈并获取其出具的声明与承诺，以及控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明。

经核查，保荐机构认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

发行人符合《首发办法》第十三条的规定。

五、发行人符合科创板定位的说明

（一）发行人符合科创板行业领域要求

公司主营业务为提供集成电路产品所需的半导体 IP 设计、授权及相关服务，主要产品及服务包括模拟及数模混合 IP、嵌入式存储 IP、无线射频通信 IP 与有线连接接口 IP 等半导体 IP 授权服务和以物理 IP 技术为核心竞争力的芯片定制服务等。公司所属行业为集成电路设计产业。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，发行人行业领域归属于第四条第（一）项“新一代信息技术领域”，符合科创板行业领域要求。

（二）发行人科创属性符合要求

根据《科创属性评价指引（试行）》，发行人符合科创属性评价标准一，具体情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元	是	公司最近三年累计实现营业收入 70,389.65 万元，累计研发投入占累计营业收入的比例为 13.90%，大于 5%；公司最近三年累计研发投入金额为 9,782.44 万元，大于 6,000.00 万元。
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	是	2021 年末公司研发人员人数为 91 人，占当年员工总数的比例为 57.59%，不低于 10%。
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利） ≥ 5 项	是	截至本发行保荐书出具日，公司形成主营业务收入的发明专利为 50 项，大于 5 项。
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ，或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿	是	2019 年至 2021 年，公司营业收入分别为 10,495.98 万元、23,183.26 万元、36,710.41 万元，营业收入的复合增长率为 87.02%，大于 20%。

综上所述，发行人科创属性符合科创板定位要求，符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法规的规定。

（三）发行人科技创新能力突出

1、发行人专注于物理 IP 技术，主营业务符合国家科技创新战略

集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。我国集成电路产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。2021年12月，《“十四五”国家信息化规划》指出，加快集成电路关键技术攻关；推动计算芯片、存储芯片等创新；加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将集成电路作为事关国家安全和全局的基础核心领域之一。IP作为集成电路行业的最上游，是构建芯片底层架构的核心要素，具有极高的技术难度和价值含量。国家和社会对IP行业重视程度日益提升，对国内IP企业的认知、理解和支持也不断加强。

公司专注于物理IP技术的研发与创新，在低功耗电源管理、低功耗高精度时钟、低功耗信号转换、嵌入式MTP存储、嵌入式eFlash存储、无线射频通信、有线连接接口传输等物理IP技术领域取得丰厚的研发成果，已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系。公司积累和沉淀的物理IP技术，能够有效补足我国集成电路在芯片设计核心要素上的短板，增强集成电路相关领域的科技创新，提升技术创新能力和产业发展的质量和自主权。

公司拥有从14nm到180nm工艺节点的IP设计能力和芯片定制服务能力，可满足不同类型客户的应用场景和特定需求。作为国内主要的物理IP供应商之一，公司聚焦国内业务可与客户进行深度合作，实现IP设计与芯片产品功耗、尺寸、性能、成本等各方面指标达到平衡的最优方案。公司终端客户涵盖多个国内外知名企业，协助客户打造了应用于物联网领域的多种芯片解决方案。

公司持续进行物理IP技术的研发，其研发成果转化成的产品与服务能够提高物联网芯片乃至物联网设备的市场竞争力、物联网生态的多样化，并通过上述客户与合作伙伴最终设计或制造的产品应用于消费级和产业级的各物联网细分领域，实现了与产业链上下游的深度合作及与物联网产业的深度融合。

截至本发行保荐书出具日，公司已拥有境内外发明专利50项、PCT专利3项、境内实用新型专利51项，并承担了十余项省市级重大科研项目，积极开展关键核心技术攻关。公司承担的科研项目包括基于先进/主流工艺的超低功耗模拟IP平台、超低功耗物联网IP平台开发及产业化等模拟IP领域项目；适用于汽车电子的多次可编程嵌入式非挥发存储器研究等嵌入式存储IP领域项目。

2、公司拥有丰富的物理 IP 类别，产品优势显著

公司自 2011 年成立起，便聚焦物联网市场需求进行物理 IP 技术布局 and 探索，占据了一定的先发优势，形成了较为完整的主要物理 IP 类别覆盖。目前，公司已拥有覆盖全球 20 多家晶圆厂、14nm~180nm 等多种工艺类型的 500 多项物理 IP，为可穿戴设备、智能家居、智慧城市、车联网、智慧工业等多个物联网领域提供以物理 IP 技术为核心竞争力的解决方案。

根据 IPnest 报告，锐成芯微是中国大陆排名第二、全球排名第二十一的半导体 IP 供应商。同时，锐成芯微作为中国主要的物理 IP 供应商之一，在模拟及数模混合 IP、无线射频通信 IP 等细分领域具有显著的竞争优势。其中，公司的模拟及数模混合 IP 排名中国第一、全球第三，2021 年全球市场占有率为 6.6%；公司的无线射频通信 IP 排名中国第一、全球第三，2021 年全球市场占有率为 4.5%。

公司的模拟及数模混合 IP、嵌入式存储 IP、无线射频通信 IP、有线连接接口 IP 方面已应用于多个物联网应用场景，可有效满足物联网各应用场景中低功耗、高可靠性、小面积的特性需求。从技术维度而言，丰富的物理 IP 类别可在客户采购多项物理 IP 时通过优化和精简电路，实现整体芯片更优的性能功耗比、更小的面积；从市场维度而言，也可协助客户完成一站式 IP 采购，根据特定应用搭建的全套物理 IP 解决方案，减小客户芯片设计时的 IP 模块集成风险等，缩短产品开发周期。同时，丰富的物理 IP 产品线亦是公司开展芯片定制服务的核心竞争力，提高了公司芯片定制服务的质量和水平，具有良好的协同效应。

3、公司与产业链保持紧密合作，行业知名度较高

公司不仅与下游客户建立了良好的合作关系，与晶圆厂等产业链合作伙伴也进行紧密合作。公司通过与晶圆厂合作搭建 IP 工艺平台、开展芯片定制服务等，拓宽物理 IP 所覆盖的工艺类型和节点，丰富了产品下游应用领域和可服务的客户群体。目前，公司已与超过 20 家晶圆厂建立合作，实现了与产业链上下游的深度合作。公司已成为三星 SAFE™ IP 合作伙伴计划成员、中芯国际 IP 生态联盟成员。中芯国际、华虹半导体、晶合集成、华润上华、中芯绍兴等晶圆厂也向公司采购物理 IP，增加其工艺线对应 IP 生态体系的丰富度和多样性，共同搭建服务于更多终端客户的工艺平台，获取更多物联网领域不同类型、不同需求、不

同应用场景客户的合作机会。

公司自成立以来专注于物理 IP 技术的研发，截至本招股说明书签署日，公司已拥有境内外发明专利 50 项、PCT 专利 3 项、境内实用新型专利 51 项，并获得多项行业荣誉与社会认可。2021 年，公司获中国电子信息产业发展研究院“2021 年第十六届中国芯优秀支撑服务企业”、公司“超低功耗物联网 IP 平台的研发及创新应用”项目入选工信部 2020-2021 年度物联网关键技术与平台创新类示范项目；2020 年，公司获工信部国家级专精特新“小巨人”企业、“四川省瞪羚企业”荣誉称号、获“2020 年四川企业技术创新发展能力 100 强企业”称号并被认定超低功耗集成电路 IP 设计处于国内领先水平；2019 年，公司获“四川省企业技术中心”认证。

4、发行人具备完善的技术创新机制、技术储备及技术创新的安排

（1）技术创新机制

1) 紧贴市场需求的研发机制

为完善研发机制，公司制定了多项技术研发管理、技术成果转化、激励创新及研发人才梯队建设的管理制度，并成立技术委员会，确定研发方向、重点课题和经费预算等重大问题，制定中远期研发规划。在此基础上，技术研发中心每年制定具体的技术创新研发计划，明确目标和措施，并根据市场情况及时进行动态调整。

此外，公司的市场团队积极参与 ICCAD 中国集成电路设计业年会、世界半导体大会等技术论坛，密切跟踪相关行业的发展需求，分析公司的技术能力和潜力，发掘出适合公司技术发展的新机遇，形成市场研究报告，为研发团队提供研发方向参考。

2) 全方位的人才培养机制

公司注重创新型人才团队的建设，鼓励开展技术分享与内部培训，搭建技术分享平台。此外，公司通过邀请行业专家举办技术分享会、组织员工参加行业技术培训等方式，充分激发团队研发活力。

其次，公司通过与各大高校建立校企合作培养方案，定向培养集成电路行业

人才。公司与电子科技大学、四川大学联合建立了“集成电路联合研发中心”、“集成电路实训基地”，并担任电子科技大学“产学研协同育人联盟成员单位”、成都信息工程大学“集成电路设计及微系统封装测试”单位、“集成电路实训基地”等。公司积极开展技术骨干走进高校技术分享培训或在校学生走进公司参观学习等活动，加强了校企人才培养合作，为人才的培养和引进奠定良好基础。

3) 完善的激励机制

在激励制度方面，公司积极营造舒适良好的工作环境，薪酬体系和福利计划，公司每年定期根据技术与研发人员的能力和工作表现，对其薪酬进行相应调整，以保持技术与研发人员薪酬水平的市场竞争力。公司鼓励研发人员申报科技成果项目和国内外相关专利，制定知识产权及专利申请与授权奖励管理等相关方案，对工程师的技术发明和创新均给予奖励。公司每年设立技术创新奖、优秀专利奖、优秀团队奖等奖项，激励研发人员的自我提升意识和集体荣誉感。公司还设立了股权激励措施，为符合条件的员工进行激励，将员工与公司发展的长期利益相结合，充分调动研发人员积极性和稳定。

(2) 技术储备及技术创新的安排

截至本发行保荐书出具日，公司已拥有境内外发明专利 50 项、PCT 专利 3 项、境内实用新型专利 51 项及丰富的技术储备。

公司从物联网芯片所需的物理 IP 出发，积极与物联网领域客户探索低功耗、小面积与高可靠性的芯片设计开发。此外，公司持续关注市场中具有创新技术的 IP 公司，结合公司发展战略和技术发展方向进行并购整合。

综上所述，发行人所属行业领域和科创属性均符合科创板定位要求，符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法规的规定。

六、发行人存在的主要问题和风险

本着勤勉尽责、诚实守信的原则，经过全面的尽职调查和审慎的核查，根据发行人的有关经营情况及业务特点，保荐机构特对发行人以下风险做出提示和说明：

（一）技术升级迭代及研发方向与应用市场需求不一致的风险

集成电路行业技术迭代速度快，除了芯片制程不断朝着先进工艺节点发展外，特色工艺、先进封装、新应用等发展路径也成为重要发展方向，技术种类多样，整个行业处于不断革新的阶段，对合理选择技术路线及研发技术升级提出了较高的要求。在半导体 IP 领域，越来越多的集成电路设计以半导体 IP 为基础开展，IP 供应商的重要性不断提高，但同时市场多样化、快速迭代的需求也对 IP 供应商如何紧跟甚至引领行业发展的能力提出更高要求。公司自成立以来始终围绕物联网芯片所需的物理 IP 进行技术研发与产品布局，需持续保持研发投入，紧密关注行业技术发展动态，尽量降低研发存在的不确定性风险。如公司新技术的开发不及预期，或无法在行业中保持先进优势，将导致公司产品市场竞争力下降，存在技术升级迭代风险。

公司半导体 IP 技术研发和创新重点围绕物联网需求开展，而物联网市场应用方向众多，智能制造、车联网等应用方向仍处于培育期，新应用方向不断涌现。此外，由于物联网市场定制化程度较高，不同领域客户在应用方案中功能、性能、功耗和成本存在多样化的开发需求。公司产品开发需时刻与客户保持深度沟通，充分理解市场应用需求，才能形成独特的市场竞争优势。

半导体 IP 具有十分显著的规模性效应，在激烈的竞争环境中，IP 供应商可能会由于研发方向契合市场近期发展需求而出现爆发式增长，亦可能由于研发方向偏离市场需求而出现增长停滞的情形。报告期内，公司半导体 IP 授权服务业务产生的毛利占主营业务毛利比例较高，分别为 66.45%、76.10%、66.23%，对公司持续提升盈利水平较为重要。如果公司研发新产品或对现有产品升级无法紧密契合市场发展趋势、满足下游客户的需求，则公司相关 IP 产品将难以充分发挥规模效应，将面临着经营业绩无法保持持续快速增长的风险，对公司的研发实力、生产经营和竞争力产生不利影响。

（二）市场竞争风险

根据 IPnest 数据，2021 年 IP 市场规模为 54.51 亿美元，预计 2026 年为 106.85 亿美元，其中，2021 年物理 IP 在 IP 市场中占比约 40%，规模为 22.69 亿美元，预计 2026 年为 46.13 亿美元。物理 IP 系技术密集型行业，且在集成电路行业中

地位较为重要，在全球范围内行业竞争较为激烈。其中，新思科技、铿腾电子、ARM 等国际同行业巨头自设立至今已经历三十至四十年发展，且持续在全球范围内并购整合，产品种类齐全，销售网络广泛，长期以来在国际市场上享有较高市场知名度和认可度，业务规模相对较大，整体上具备较为明显的竞争优势。与国际同行业巨头相比，公司起步较晚，在技术储备、销售网络、市场知名度等方面还存在明显差距，市场份额相对较小，在国际市场竞争力较弱。报告期内，公司半导体 IP 授权服务业务收入分别为 1,740.48 万元、4,657.32 万元、8,209.43 万元，与国际同行业巨头每年数亿乃至数十亿美元收入相比差距显著。根据 IPnest 报告，在公司 IP 产品中，相对具备竞争力的模拟及数模混合 IP、无线射频通信 IP 在 2021 年均排名中国第一、全球第三，但全球市场占有率分别为 6.6%、4.5%，相对较低。同时，随着国内产业政策支持半导体 IP 行业发展，各方面资本不断提升行业投资力度，国内 IP 厂商不断涌现且持续增加技术投入，市场竞争也将愈发激烈，如果公司不能保持市场竞争力，届时存在公司的市场份额被侵蚀风险。

（三）收入无法持续快速增长的风险

报告期内，公司营业收入分别为 10,495.98 万元、23,183.26 万元、36,710.41 万元，增长率分别为 120.88%、58.35%，其中半导体 IP 授权服务业务和芯片定制服务收入均快速增长，公司面临未来收入无法持续快速增长的风险。

1、半导体 IP 授权服务业务增长减缓甚至停滞的风险

报告期内，公司半导体 IP 授权服务业务收入分别为 1,740.48 万元、4,657.32 万元、8,209.43 万元，公司半导体 IP 产品主要为模拟及数模混合 IP、嵌入式存储 IP、无线射频通信 IP 及有线连接接口 IP，目前各类 IP 产品正处于快速推广或导入相关市场关键阶段，收入能否持续快速增长面临一定不确定性。如果公司研发 IP 新产品或对现有 IP 产品升级无法满足下游客户的需求或下游客户产品大规模量产和市场推广不及预期，公司相关 IP 产品所形成的授权使用费或特许权使用费将无法持续增长，甚至在细分类别中出现下降，公司半导体 IP 授权服务业务面临增长减缓甚至停滞的风险。

2、芯片定制服务收入波动及客户变动的风险

报告期内，公司芯片定制服务收入分别为 8,722.43 万元、17,557.37 万元、

25,715.91 万元，其中晶圆制造工程服务收入分别为 8,698.43 万元、17,525.39 万元、25,248.52 万元，增长较快。公司芯片定制服务尤其是晶圆制造工程服务的收入与客户相应产品出货规划及实际情况直接相关，受到客户所在市场、客户自身经营等多因素影响，且公司芯片定制服务客户群体具有多元化特征，涉及众多下游市场，因此不排除未来由于部分客户下游市场波动或客户自身变动而造成公司芯片定制服务业务收入出现波动甚至下降的风险。

（四）芯片定制服务业务供应商集中的风险

在公司的芯片定制服务业务中，上游主要为晶圆制造、封装和测试领域，该等领域供应商集中是集成电路行业特点之一，对公司供应商管理能力提出了较高要求。尽管公司各外包环节的供应商均为知名的晶圆制造厂及封装测试厂，其内部有较严格的质量控制标准，公司对供应商质量进行严密监控，但仍存在某一环节出现质量问题进而影响最终芯片产品可靠性与稳定性的可能。

目前公司合作的晶圆代工厂主要包括中芯国际、华虹宏力和华润上华等，合作的封装测试厂主要包括华天科技、上海伟测、甬矽电子等。报告期内，公司向五大供应商合计采购金额占当期采购总额的比例为 93.45%、82.97%、86.31%，向中芯国际采购金额占当期采购总额的比例为 55.57%、46.35%、68.12%，集中度较高。如果前述晶圆及封测供应商发生重大自然灾害、国际政治经济形势剧烈变动、其他不可抗力因素等突发事件，或者由于晶圆供货短缺、产能不足或者生产管理水平和欠佳等原因影响公司产品的正常生产和交付进度，则将对公司产品的出货和销售造成不利影响，进而影响公司的经营业绩和盈利能力。

（五）毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 18.95%、21.75%、29.85%，毛利率逐渐上升。公司业务主要包括半导体 IP 授权服务业务、芯片定制服务业务及蓝牙芯片销售业务。其中，报告期内公司半导体 IP 授权服务业务毛利率分别为 75.72%、82.25%、88.39%，逐年上升；报告期内公司芯片定制服务业务毛利率分别为 7.63%、6.40%、11.68%，存在一定波动。公司主营业务毛利率变动主要受业务占比变动及各业务细分毛利率变动影响。一方面，公司半导体 IP 授权服务业务和芯片定制服务业务毛利率差异较大，如果公司未来业务结构发生变化，

将导致公司主营业务毛利率相应波动；另一方面，报告期内公司半导体 IP 授权服务业务毛利率较高，未来公司必须根据市场需求不断进行技术迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化、技术实力停滞不前或行业地位下降，该等业务毛利率可能下降，进而导致公司主营业务毛利率下降；此外，公司芯片定制服务业务毛利率可能受战略性客户项目影响而有所波动。上述因素均有可能导致公司主营业务毛利率发生波动，进而相应影响公司经营业绩。

（六）新冠疫情风险

2020 年以来，全球范围内新冠疫情持续反复，公司日常经营需配合国家整体疫情防控工作而进行，各项限制措施在不同程度上会对公司经营情况造成不利影响。公司 2019 年至 2021 年营业收入分别为 10,495.98 万元、23,183.26 万元、36,710.41 万元，归属于发行人股东的净利润分别为-1,534.95 万元、375.10 万元、4,658.51 万元，在疫情影响下 2020 年和 2021 年仍呈现出快速增长的趋势，同时截至本发行保荐书出具日公司各项业务在手订单较为充足，在手订单执行尚未出现由于新冠疫情影响而严重停滞的情况。2022 年上半年，国内主要供应商所在部分地区相继出现不同程度的疫情爆发，同时公司客户自身采购及出货规划也可能受到当地疫情相关限制措施的影响。因此，在当前疫情形势下，公司自身经营以及上下游产业链的运行情况难以可靠预计，公司未来经营成果存在受新冠疫情影响而产生波动的风险。

七、发行人的发展前景评价

（一）发行人所处行业未来发展前景

1、国家及产业政策对集成电路企业予以大力扶持

集成电路行业是现代信息产业的基础和核心产业之一，是支撑国民经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来，随着国家经济质量的提升，集成电路行业对于国民经济发展的战略意义更加凸显，国家及产业政策密集出台。2020 年 8 月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，对于国家鼓励的集成电路企业，特别是先进的集成电路企业，予以大幅度税收减免。2020 年 11 月中共中央《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规

划和二〇三五年远景目标的建议》指出，集成电路作为强化国家战略科技力量的重点发展方向之一，是我国坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势的核心战略组成部分。

国家及产业政策的大力支持为行业创造了良好的政策环境和企业发展基础，为集成电路行业发展指引了方向。国内部分优质的集成电路企业得益于各项扶持政策，进入快速成长通道，在其各自细分领域实现国产替代，并开始与全球领先企业同台竞争，在全球市场上占有一席之地。

2、半导体 IP 行业规模持续增长

随着集成电路工艺技术不断进步、芯片的性能要求及设计规模不断提升，为有效降低芯片开发成本、缩短开发周期、提升产品竞争力，以 IP 复用为基础的 SoC 设计成为集成电路行业的重要发展方向，半导体 IP 越来越成为集成电路设计工作的关键组成部分。根据 IPnest 数据，2021 年 IP 整体市场规模为 54.51 亿美元，预计 2026 年将达 106.85 亿美元。

近年来随着互联网、移动通信及人工智能等技术发展，各类电子设备对数据感知、传输、存储、处理的需求不断提高，物理 IP 迎来持续增长。根据 IPnest 数据，2021 年物理 IP 在 IP 整体市场中占比约 40%，规模达 22.69 亿美元，预计 2026 年物理 IP 市场规模将达 46.13 亿美元。其中，接口 IP 和存储 IP 的增长速度最快，2017-2021 年复合增长率分别为 16.96%和 11.72%。

3、SoC 芯片设计复杂度提升，带动 IP 种类和数量需求进一步增加

在信息技术日新月异的发展与智能终端的集成化趋势不断增强的背景下，SoC 逐步成为集成电路设计的主流发展方向。SoC 芯片通过将系统的处理器、模拟电路、存储器等多种电路模块综合到一块芯片中，整体实现信号感知、数据处理、通信及存储等功能，可最大限度地满足用户对芯片复杂功能的要求。

随着 SoC 芯片的性能提升与规模扩大，若每一次产品开发都要对每个模块重新设计并进行系统整合和验证，开发周期将越来越长，同时设计质量与成本也难以把控。因此，采用基于 IP 复用技术的 SoC 设计思路成为解决上述问题最有效的方案，通过验证成熟的 IP 复用将特定功能模块化和商业化，IP 的种类和数量也不断增加，从而快速实现芯片的复杂功能、降低设计风险与开发成本、大幅

缩短产品上市时间。

4、芯片设计服务行业将迎来高速发展期

随着工艺节点不断向前演进、集成电路设计复杂度上升，设计难度与成本不断提高。同时，芯片设计、晶圆制造及封装测试各环节垂直化、精细化分工的趋势日益显著。芯片设计服务提供商通过整合自身在关键 IP 授权、半导体工艺理解、先进设计方法及生产管理经验等各方面的优势，可协助芯片设计公司在保证设计质量的基础上，缩短设计周期、提高产品上市速度并抢占市场先机。

近年来，在国家政策扶持以及人工智能、物联网、汽车电子等下游应用市场带动下，中国集成电路行业保持快速增长，继续保持增速全球领先的势头。根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路设计市场销售收入超过 4,500 亿，近五年年均复合增长率为 21.50%。根据 ICCAD 数据，2021 年中国集成电路设计超过 2,800 家，受益于集成电路设计行业的迅速增长，芯片设计服务行业作为其上游产业也将迎来高速发展期。

（二）发行人的市场地位及竞争优势评价

1、发行人市场地位

物理 IP 细分领域众多且各细分领域的龙头企业重合度较低，整体市场相对分散。行业巨头尽管整体业务规模相对较大，但无法在所有细分领域中均保持绝对的领先地位。SST、Alphawave、eMemory 等其他领先厂商虽专注于嵌入式存储 IP、接口 IP 等细分领域，整体业务规模相对较小，但凭借其擅长且市场份额占优的 IP 细分类别，实现了业务的快速增长和市场地位的迅速提升。国内物理 IP 厂商起步较晚，发展规模多数较小，市场份额较国际龙头企业有一定差距。

根据 IPnest 报告，锐成芯微是中国大陆排名第二、全球排名第二十一的半导体 IP 供应商。同时，锐成芯微作为中国主要的物理 IP 供应商之一，在模拟及数模混合 IP、无线射频通信 IP 等物理 IP 细分领域具有显著的竞争优势。其中，公司的模拟及数模混合 IP 排名中国第一、全球第三，2021 年全球市场占有率为 6.6%；公司的无线射频通信 IP 排名中国第一、全球第三，2021 年全球市场占有率为 4.5%。

2、发行人竞争优势

（1）物理 IP 类别丰富，产品优势显著

公司自 2011 年成立起，便聚焦物联网市场需求进行物理 IP 技术布局和探索，占据了一定的先发优势，形成了较为完整的主要物理 IP 类别覆盖。目前，公司已拥有覆盖全球 20 多家晶圆厂、14nm~180nm 等多种工艺类型的 500 多项物理 IP，为可穿戴设备、智慧家居、智慧城市、车联网、智慧工业等多个物联网领域提供以物理 IP 技术为核心竞争力的解决方案。

根据 IPnest 报告，锐成芯微是中国大陆排名第二、全球排名第二十一的半导体 IP 供应商。同时，锐成芯微作为中国主要的物理 IP 供应商之一，在模拟及数模混合 IP、无线射频通信 IP 等物理 IP 细分领域具有显著的竞争优势。其中，公司的模拟及数模混合 IP 排名中国第一、全球第三，2021 年全球市场占有率为 6.6%；公司的无线射频通信 IP 排名中国第一、全球第三，2021 年全球市场占有率为 4.5%。

公司的模拟及数模混合 IP、嵌入式存储 IP、无线射频通信 IP、有线连接接口 IP 方面已应用于多个物联网应用场景，可有效满足物联网各应用场景中低功耗、高可靠性、小面积的特性需求。从技术维度而言，丰富的物理 IP 类别可在客户采购多项物理 IP 时通过优化和精简电路，实现整体芯片更优的性能功耗比、更小的面积；从市场维度而言，也可协助客户完成一站式 IP 采购，根据特定应用搭建的全套物理 IP 解决方案，减小客户芯片设计时的 IP 模块集成风险等，缩短产品开发周期。同时，丰富的物理 IP 产品线亦是公司开展芯片定制服务的核心竞争力，提高了公司芯片定制服务的质量和水平，具有良好的协同效应。

（2）专注于物理 IP 技术，得到下游客户广泛认可

公司专注于物理 IP 技术的研发与创新，在低功耗电源管理、低功耗高精度时钟、低功耗信号转换、嵌入式 MTP 存储、嵌入式 eFlash 存储、无线射频通信、有线连接接口传输等物理 IP 技术领域取得丰厚的研发成果，已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系。公司积累和沉淀的物理 IP 技术，能够有效补足我国集成电路在芯片设计核心要素上的短板，增强集成电路相关领域的科技创新，提升技术创新能力和产业发展的质量和自主权。

公司拥有从 14nm 到 180nm 工艺节点的 IP 设计能力和芯片定制服务能力，可满足不同类型客户的应用场景和特定需求。作为国内主要的物理 IP 供应商之

一，公司具有本土化优势，可与客户进行深度合作，实现 IP 设计与芯片产品在功耗、尺寸、性能、成本等各方面指标达到平衡的最优方案。公司终端客户涵盖多个国内外知名企业，协助客户打造了应用于物联网领域的多种芯片解决方案。

截至本发行保荐书出具日，公司已拥有境内外发明专利 50 项、PCT 专利 3 项、境内实用新型专利 51 项，并承担了十余项省市级重大科研项目，积极开展关键核心技术攻关。公司承担的科研项目包括基于先进/主流工艺的超低功耗模拟 IP 平台、超低功耗物联网 IP 平台开发及产业化等模拟 IP 领域项目；适用于汽车电子的多次可编程嵌入式非挥发存储器研究等嵌入式存储 IP 领域项目。

（3）产业链合作紧密，行业知名度较高

公司不仅与下游客户建立了良好的合作关系，与晶圆厂等产业链合作伙伴也进行紧密合作。公司通过与晶圆厂合作搭建 IP 工艺平台、开展芯片定制服务等，拓宽物理 IP 所覆盖的工艺类型和节点，丰富了产品下游应用领域和可服务的客户群体。目前，公司已与超过 20 家晶圆厂建立合作，实现了与产业链上下游的深度合作。公司已成为三星 SAFE™ IP 合作伙伴计划成员、中芯国际 IP 生态联盟成员。中芯国际、华虹半导体、晶合集成、华润上华、中芯绍兴等晶圆厂也向公司采购物理 IP，增加其工艺线对应 IP 生态体系的丰富度和多样性，共同搭建服务于更多终端客户的工艺平台，获取更多物联网领域不同类型、不同需求、不同应用场景客户的合作机会。

公司在产业链的技术积累和丰富的合作经验，也获得多项行业荣誉与社会认可。2021 年，公司获颁工信部国家级专精特新“小巨人”企业、中国电子信息产业发展研究院“2021 年第十六届中国芯优秀支撑服务企业”、获“2020 年四川企业技术创新发展能力 100 强企业”称号并被认定超低功耗集成电路 IP 设计处于国内领先水平、公司“超低功耗物联网 IP 平台的研发及创新应用”项目入选工信部 2020-2021 年度物联网关键技术与平台创新类示范项目；2020 年，公司获“四川省瞪羚企业”荣誉称号；2019 年，公司获“四川省企业技术中心”认证。

（4）具备丰富并购经验，业务整合能力较强

半导体 IP 行业准入门槛高、研发投入大、产品开发要求高，其中物理 IP 细

分种类繁多、各类 IP 存在一定技术差异。若企业仅依靠自身研发形成完善的 IP 产品线所需时间较长，需通过并购完成各类物理 IP 布局、夯实并提升技术水平。

公司聚焦物联网芯片所需物理 IP，实时跟踪行业技术动态与物联网市场发展趋势，选择具有技术优势和市场潜力的标的择机完成收购，拥有丰富的行业并购经验和整合能力。

2016 年，公司并购 CMT，并结合自身在嵌入式存储 IP 领域的前期研发积累推出 MTP IP。随着公司逐步完善嵌入式存储 IP 的技术积累，现已推出可靠性高、数据保持能力强的多种嵌入式存储 IP 产品。

2020 年，公司完成对盛芯微的并购，并基于在无线射频通信领域的前期研发积累，于多个工艺节点及晶圆厂推出蓝牙射频 IP。

通过并购整合，公司在并购标的技术基础上进一步深入研发，提升核心技术水平、丰富物理 IP 布局、增强产品市场竞争力。

八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，招商证券就本项目中招商证券及服务对象有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为的核查意见如下：

（一）招商证券在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的情况

截至本发行保荐书出具之日，招商证券在本次成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

（二）发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的情况

发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的相关情况如下：

1、发行人聘请招商证券股份有限公司作为本项目的保荐机构，聘请北京市金杜律师事务所作为本项目的发行人律师，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的审计机构、验资机构及验资复核机构，聘请上海东洲资产评估

有限公司担任资产评估复核机构。上述中介机构均为本项目依法需聘请的证券服务机构。上述中介机构依法出具了专业意见或报告。

2、除上述证券服务机构外，发行人存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，具体情况如下：（1）发行人聘请了邓王周廖成利律师行、King & Wood Mallesons LLP、理律律师事务所作为境外律师事务所为本次发行提供境外法律服务；（2）发行人聘请了深圳前瞻资讯股份有限公司对本次发行的募集资金投资项目提供可行性分析服务，协助发行人完成上市工作；（3）聘请了北京荣大科技股份有限公司提供专业图文材料制作与信息咨询服务，协助发行人完成上市工作；（4）聘请深圳市观合法律翻译事务所有限公司提供申报文件外文资料翻译服务，协助发行人完成上市工作；（5）聘请北京细软智谷知识产权代理有限公司提供境外专利、商标的核查服务。

发行人存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，上述第三方皆是为发行人提供首次公开发行并上市过程中所需的服务，聘请其他第三方具有必要性，其聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。

综上，经核查，本保荐机构认为：

1、招商证券在本次项目中不存在直接或间接聘请第三方机构的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。

2、发行人在本项目中依法聘请了招商证券股份有限公司作为本项目的保荐机构，聘请北京市金杜律师事务所作为本项目的发行人律师，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的审计机构、验资机构及验资复核机构，上海东洲资产评估有限公司担任资产评估复核机构，聘请行为合法合规。除上述依法聘请的证券服务机构外，发行人在本项目中，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，上述第三方皆是为发行人提供首次公开发行并上市过程中所需的服务，聘请其他第三方具有必要性，其聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。

九、对本次证券发行的推荐意见

综上所述，本保荐机构认为，发行人的本次发行符合《证券法》《首发办法》等有关规定，本保荐机构认真审核了全套申请材料，并对发行人进行了实地考察。在对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的可行性、有利条件、风险因素及对发行人未来发展的影响等方面进行了深入分析的基础上，本保荐机构认为发行人符合《证券法》《首发办法》等相关文件规定，同意保荐成都锐成芯微科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市。

附件：《招商证券股份有限公司关于成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐代表人专项授权书》

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签章页)

项目协办人

签名:汪军鹏 汪军鹏

保荐代表人

签名:姜博 姜博

签名:王越 王越

保荐业务部门负责人

签名:王炳全 王炳全

内核负责人

签名:陈鋈 陈鋈

保荐业务负责人

签名:王治鉴 王治鉴

保荐机构总经理

签名:吴宗敏 吴宗敏

保荐机构法定代表人

签名:霍达 霍达



招商证券股份有限公司

2022年6月20日

附件：

招商证券股份有限公司关于成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐代表人专项授权书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，招商证券授权姜博、王越两位同志担任成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人，负责该公司发行上市的尽职调查及持续督导等保荐工作事宜。

特此授权。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐代表人专项授权书》之签章页)

保荐代表人签字:



姜 博



王 越

法定代表人签字:



霍 达



招商证券股份有限公司

2022年6月20日